

第30回若手研究会セミナー

【プリント配線板の製造技術の基礎と最新の技術動向】

～高密度化と高速大容量データに向けた材料・プロセス・評価～



2024年1月19日（金） 12:50～17:00

開催方式：現地参加&オンライン視聴（ハイブリッド開催）

現地：大阪公立大学I-siteなんば2階 定員 50名

URL:<https://www.omu.ac.jp/isite/>

オンライン参加(ZOOMウェビナー)：定員100名

講師：株式会社メイコー 高橋泰子氏

講演概要：電子部品同士を配線し、回路を形成するために使用されるプリント基板。プリント基板は、エレクトロニクス製品の進化に追従しながら、多様な方向へ開発が進んでいる。その開発の歴史や流れを紹介するとともに、プリント基板の基本的な製造プロセスを実際の製造工程動画で分かりやすく解説。また、高密度細線化のための回路形成技術や発熱部品に対する放熱技術など多様化するプリント基板技術について概説する。

講師：RITAエレクトロニクス株式会社 田中顕裕氏

講演概要：高速大容量データ伝送とは一定の時間にできるだけ多くのデータを伝送することであり、データの最小単位である1ビットあたり時間は短くなり、伝搬信号が高周波化する。プリント基板では信号用配線の高周波・低伝送損失化が必要となり、この基礎を概説する。また、低誘電率・低誘電正接絶縁層やロープロファイル銅はく等の材料面や、スルーホールに対するバックドリル加工等の構造面の効果を具体的に説明する。

プログラム

(若干時間が前後することがあります、また、タイトルは仮題です)

12 : 50～12 : 55

開催の挨拶

12 : 55～14 : 05

プリント基板の概要とその製造プロセス (高橋氏)

14 : 05～14 : 20

休憩

14 : 20～15 : 20

プリント基板の製造プロセスの進化と今後の動向 (高橋氏)

15 : 20～15 : 35

休憩

15 : 35～16 : 55

高速大容量データ伝送に向けたプリント基板の基礎
(田中氏)

16 : 55～17 : 00 閉会

* 定員150名(先着申込順)

* 参加費「クーポン利用可：1名/枚」

会員/賛助会員/協賛会員 (JPCA会員含む) : 3,000円

シニア会員 : 2,000円、非会員 : 5,000円

学生会員 : 無料、非会員学生 : 1,000円

* 申し込みは、下記からお願いします。(締切：1月17日迄)

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

申込QR
コード

* 注意事項 *

- ・各申込みサイトから、ご自身が該当する項目を選択いただき申し込みをお願いします。
- ・発表者・スポンサー申込：事前の登録が必要です。
- ・クーポン使用：クーポン番号の入力が必要です。
- ・請求書、領収書の発行：申込登録完了のメールのマイページURL⇒ログイン⇒決済⇒出力
- ・支払方法：振込み…手数料負担ください。カード決済…手数料なし(学会負担)
クレジット決済をお勧め致します。



問合先：エレクトロニクス実装学会関西支部事務局
info@jiep.or.jpにご連絡ください